

# 擔心對**產業發展趨勢** 與**現況**不夠了解嗎？

還在摸索未來的道路嗎？想加入科技產業變成達人嗎？

106學年度下學期

## 進階電子構裝 理論與實務

為搭起學校與產業的橋梁，讓學習與就業能無縫接軌，本課程規劃完整課程活動，藉由業師講授電子構裝產品應用實務與技術發展趨勢，培養你/妳成為業界所需之封裝、測試人才。透過課程，可以讓你/妳了解封測產業發展現況及趨勢，提前發展所需技能，讓你贏在起跑點，開啟就業的康莊大道。

### 【課程介紹】

**理論課程** 由產業界具有豐富實務經驗之工程專家及管理階層親自授課。生動的教學與經驗分享讓你快速地深入瞭解各種IC封裝之材料、製程及應用，讓完成本課程的你/妳，具備在封測產業相關職務的基礎知識。

- (1)業師講授專業內容，計9週/學期
- (2)專題演講，計2週/學期

**實務課程** 課程中除安排課堂講授外，另安排

- (1)企業參訪。
- (2)同學與產業進行產學研究，完成期末專題報告。

參考用書：  
矽品講師規劃課程資料

### 【學習成績優良 獎學金】

為獎勵優秀之在校學生修習本課程，特設置「矽品獎學金」，每學期名額6名，每名補助新台幣5,000元整

### 【就業機會】

凡曾修習過本實務學分課程(上下學期，且獲頒合格證書)之同學，向矽品精密公司提出申請，即可優先安排研發替代役/一般職缺面試

合作單位：



國立中央大學  
材料科學與工程學系  
Department of Materials Science and Engineering



矽品精密工業股份有限公司  
Siliconware Precision Industries Co., Ltd.